

证券代码: 688676

证券简称: 金盘科技

公告编号: 2026-012

债券代码: 118063

债券简称: 金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于筹划发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”或“金盘科技”)于 2026 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。现将有关情况公告如下:

为持续推进公司国际化战略和全球化布局,加速海外业务拓展进程,同时搭建国际化资本运作平台,增强境外融资能力,不断深化和提升公司综合竞争实力,助力公司高质量可持续发展,根据公司总体发展战略及运营需要,公司拟在境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次 H 股上市”),公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作,授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨,关于本次 H 股上市的细节尚未确定。

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,待具体方案确定后,本次 H 股上市需提交公司董事会和股东会审议,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。

本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不

确定性。公司将严格遵守相关法律法规的要求，根据本次 H 股上市的后续进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日